

## 苏州国芯科技股份有限公司

### 关于自愿披露公司研发的新一代汽车电子高性能 MCU

#### 新产品内部测试成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代汽车电子高性能 MCU 新产品“CCFC3012PT”于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下：

#### 一、 新产品的基本情况

公司本次内部测试成功的汽车电子高性能 MCU 新产品 CCFC3012PT 是基于公司自主 PowerPC 架构 C\*Core CPU 内核研发的新一代多核 MCU 芯片，适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用，可以更好地满足客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级的应用需求。

该芯片基于 40nm eFlash 工艺开发和生产，内嵌 10 个运算 CPU 核 C3007，其中包括 6 个主核和 4 个锁步核，该 CPU 核流水线采用双发射，DMIPS 性能达到 2.29/MHz，相比同系列的 CCFC3007PT 芯片单个内核性能提升了 20%。该芯片内嵌硬件安全 HSM 模块，支持 Crypto/SM2/AES/SM4 等国际和国密算法，可以支持安全启动和 OTA；芯片内嵌多种独立的汽车标准通讯接口，主要包括：支持 TSN 协议 100M/1000M 以太网接口（1 路）、FlexRay（2 路）、Lin（12 路，支持 LIN 和 UART）、CANFD（12 路）以及对外控制接口 eMIOS（32 通道）、最新版本的通用时序处理单元 GTM4（96 通道）、串行通讯接口 DSPI（22 路，支持 4 路 MSC），该芯片还配置了较大容量的存储空间，其中程序存储 Flash 最高配置可达 16.5M 字节，数据存储最高配置 Flash 最高可达 1M 字节，内存空间（SRAM）最高配置可达 2.4M 字节，具备 SDADC（14 个），SARADC（13 个）控制电路。

本次内部测试成功的汽车电子高性能 MCU 新产品 CCFC3012PT 按照汽车电子 Grade1 等级、信息安全 Evita-Full 等级、功能安全 ASIL-D 等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景，从而增加了该产品

的应用覆盖面；该产品的封装形式包括 BGA516/BGA292 等，该芯片可对标英飞凌已广泛应用于自动驾驶、智能座舱和高集成区域控制的 TC397/TC399 系列 MCU 芯片，可以作为汽车智能化辅助驾驶、智能座舱和高集成区域控制领域的功能安全和信息融合处理的 MCU 芯片。

## 二、对公司的影响

公司对上述芯片产品具有完全自主知识产权，该款新产品的研发成功进一步丰富了公司的高端汽车电子 MCU 产品系列，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响，有望为解决我国汽车尤其是新能源汽车产业高端 MCU 芯片“缺芯”问题做出贡献。

## 三、风险提示

本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工作已经在开展进行中。本次公司推出的汽车电子高性能 MCU 芯片新产品 CCFC3012PT 在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，将对公司收入及盈利带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日